

Dell EMC PowerEdge XR12

仕様詳細

メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

章 1: 仕様詳細	4
シャーシ寸法.....	5
システムの重量.....	6
プロセッサの仕様.....	6
PSU の仕様.....	6
対応オペレーティング システム.....	6
冷却ファンの仕様.....	7
システムバッテリーの仕様.....	7
拡張カードライザーの仕様.....	7
メモリーの仕様.....	7
ストレージ コントローラーの仕様.....	8
ドライブ仕様.....	9
ポートおよびコネクタの仕様.....	9
USB ポートの仕様.....	9
GPU の仕様.....	9
シリアル コネクタの仕様.....	9
NIC ポートの仕様.....	10
VGA ポートの仕様.....	10
ビデオの仕様.....	10
環境仕様.....	10
粒子状およびガス状汚染物質の仕様.....	12
Rugged 認定と仕様.....	12
温度に関する制限のマトリックス.....	13

仕様詳細

本項では、お使いのシステムの仕様詳細と環境仕様の概要を示します。

トピック：

- シャーシ寸法
- システムの重量
- プロセッサの仕様
- PSU の仕様
- 対応オペレーティング システム
- 冷却ファンの仕様
- システムバッテリーの仕様
- 拡張カードライザーの仕様
- メモリーの仕様
- ストレージコントローラーの仕様
- ドライブ仕様
- ポートおよびコネクタの仕様
- ビデオの仕様
- 環境仕様

シャーシ寸法

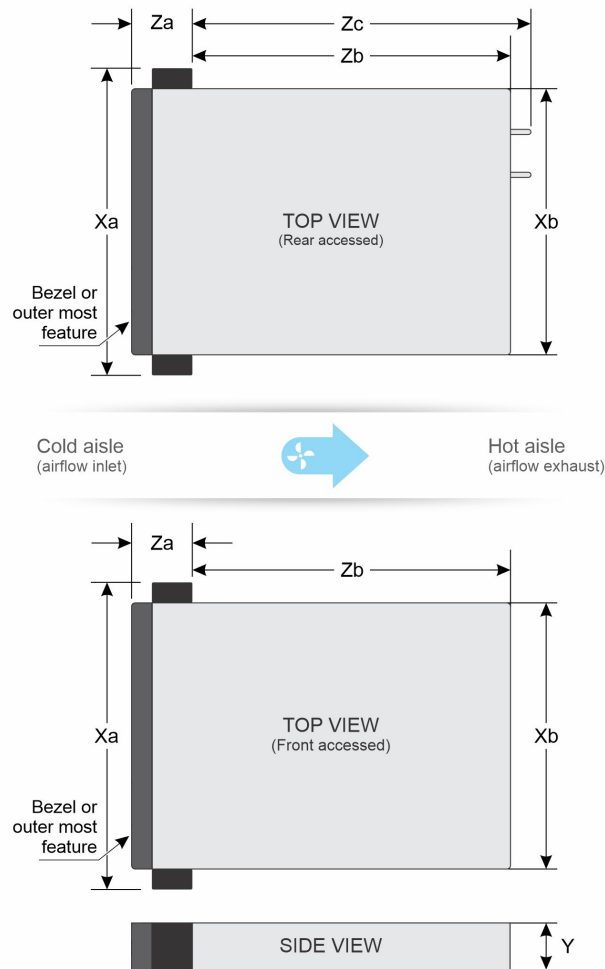


図 1. シャーシ寸法

表 1. シャーシ寸法

ドライブ	Xa	Xb	Y	Za	Zb	Zc
背面アクセス構成用の 6 x 2.5 インチ ドライブ	482.6 mm (19 インチ)	434 mm (17.08 インチ)	86.8 mm (3.41 インチ)	31 mm (1.22 インチ) ベゼルなし 45.0 mm (1.77 インチ) ベゼルあり	400 mm (15.74 インチ) イヤーから背面ウォール	432 mm (17 インチ) イヤーから背面ウォール
前面アクセス構成用の 6 x 2.5 インチ ドライブ	482.6 mm (19 インチ)	434 mm (17.08 インチ)	86.8 mm (3.41 インチ)	63 mm (2.48 インチ) ベゼルなし 153 mm (6.02 インチ)	400 mm (15.74 インチ) イヤーから背面ウォール	該当なし

システムの重量

表 2. PowerEdge XR12 システムの重量

システム設定	最大重量 (すべてのドライブ/SSD/ベゼルを含む)
背面アクセス構成の 6×2.5 インチ システム	19.5 kg (43.00 ポンド)
前面アクセス構成の 6×2.5 インチ システム	20.5 kg (45.2 ポンド)

プロセッサの仕様

表 3. PowerEdge XR12 プロセッサの仕様

サポートされるプロセッサ	サポートされているプロセッサ数
第 3 世代 インテル Xeon スケーラブル プロセッサ (最大 36 コア)	1 つ

PSU の仕様

PowerEdge XR12 システムは、最大 2 台の AC または DC 電源供給ユニット (PSU) をサポートします。

表 4. PSU の仕様

PSU	クラス	熱消費 (最大)	周波数	電圧	AC		DC	現在
					高圧線 200 ~ 240 V	低圧線 100 ~ 120 V		
1400 W 混合 モード	Platinum	5459 BTU/hr	50/60 Hz	100 ~ 240 V AC、オートレ ンジ	1400 W	1050 W	NA	12 A ~ 8 A
	NA	5459 BTU/hr	NA	DC 240 V	NA	NA	1400 W	6.6 A
1100 W	NA	4266 BTU/hr	NA	DC -48 ~ (-60) V、オ ートレンジ	NA	NA	1100 W	27 A
800 W 混合 モード	Platinum	3139 BTU/hr	50/60 Hz	100 ~ 240 V AC、オートレ ンジ	800 W	800 W	NA	9.2 A ~ 4.7 A
	NA	3139 BTU/hr	NA	DC 240 V	NA	NA	800 W	3.8 A

メモ: このシステムは、相間電圧が 240 V 以下の IT 電力システムに接続できるようにも設計されています。

メモ: 熱消費は PSU のワット定格を使用して算出されています。

メモ: システム構成を選択またはアップグレードする場合は、最適な電力使用率を達成できるように、[Dell.com/ESSA] で入手できる Dell Enterprise Infrastructure Planning Tool でシステムの電力消費量を検証します。

対応オペレーティング システム

PowerEdge XR12 システムでは、次のオペレーティング システムがサポートされています。

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Citrix Hypervisor

- Hyper-V 搭載 Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi
- リアルタイムの RHEL

詳細については、 www.dell.com/ossupport を参照してください。

冷却ファンの仕様

PowerEdge XR12 システムでは、6 個の超ハイ パフォーマンス ファンがサポートされており、6 個すべてのファンを取り付ける必要があります。

メモ: ファンのサポート構成またはマトリックスの詳細については、「[熱制限マトリックス](#)」を参照してください。

システムバッテリーの仕様

PowerEdge XR12 システムは、CR 2032 3.0 V コイン型リチウム電池システム バッテリーをサポートします。

拡張カードライザーの仕様

PowerEdge XR12 システムは、最大 5 個の PCI express (PCIe) Gen 4 拡張カードをサポートします。

表 5. システム ボードで使用できる拡張カード スロット

PCIe スロット	ライザー	PCIe スロットの高さ	PCIe スロットの長さ	PCIe レーン スロットの幅
スロット 2	ライザー 2A	フルハイト	フルレンジ	x16
スロット 1/2	ライザー 2B*	フルハイト	フルレンジ	x8+x8
スロット 3	ライザー 1A**	ロープロファイル	ハーフレンジ	x16
スロット 3	ライザー 1B*	ロープロファイル	ハーフレンジ	x8
スロット 4	ライザー 3A	フルハイト	フルレンジ	x16
スロット 4/5	ライザー 3B*	フルハイト	フルレンジ	x8+x8

メモ: * ライザー 1B、ライザー 2B、ライザー 3B の PCIe コネクターは、機械的な x16 スロットです。

メモ: ** ライザー 1A が前面アクセス構成でのみサポートされていることを示します。

注意: Dell によって検証およびテストされていない GPU、ネットワーク カード、またはその他の PCIe デバイスをシステムに取り付けしないでください。未承認の、または無効なハードウェアのインストールによって損傷が発生すると、システム保証は無効になります。

警告: エンタープライズ サーバー製品では、コンシューマーグレードの GPU を取り付けたり使用したりすることはできません。

メモリーの仕様

PowerEdge XR12 システムは、作動を最適化するために次のメモリー仕様をサポートしています。

表 6. メモリーの仕様

DIMM のタイプ	DIMM のランク	DIMM の容量	シングル プロセッサ	
			最小 RAM	最大 RAM
RDIMM	シングルランク	8 GB	8 GB	64 GB
	デュアルランク	16 GB	16 GB	128 GB
		32 GB	32 GB	256 GB
		64 GB	64 GB	512 GB
LRDIMM	クワッドランク	128 GB	128 GB	1024 GB
		256 GB	256 GB	2048 GB
インテル Optane PMem 200 シリーズ	シングルランク	128 GB	128 GB	512 GB
		256 GB	256 GB	1024 GB

表 7. メモリモジュールソケット

メモリモジュールソケット	速度
8、288 ピン	3200 MT/s

表 8. プロセッサ構成でサポートされるインテル Optane PMem 200 シリーズ

構成	説明	メモリー装着ルール		
		RDIMM	LRDIMM	インテル Optane PMem 200 シリーズ
構成 1	4 枚の RDIMM、4 枚のインテル Optane PMem 200 シリーズ	プロセッサ 1 {A1、A2、A3、A4}	-	プロセッサ 1 {A5、A6、A7、A8}
	4 枚の LRDIMM、4 枚のインテル Optane PMem 200 シリーズ	-	プロセッサ 1 {A1、A2、A3、A4}	プロセッサ 1 {A5、A6、A7、A8}
構成 2	6 枚の RDIMM、1 枚のインテル Optane PMem 200 シリーズ	プロセッサ 1 {A1、A2、A3、A4、A5、A6}	-	プロセッサ 1 {A7}
	6 枚の LRDIMM、1 枚のインテル Optane PMem 200 シリーズ	-	プロセッサ 1 {A1、A2、A3、A4、A5、A6}	プロセッサ 1 {A7}

①メモ: メモリー DIMM スロットはホット プラグ対応ではありません。

ストレージ コントローラーの仕様

表 9. PowerEdge XR12 ストレージ コントローラーの仕様

内部コントローラ	外部コントローラー
<ul style="list-style-type: none"> PERC H755 PERC H345* PERC PERC H355* HBA355i S150 	<ul style="list-style-type: none"> PERC H840 HBA355e

表 9. PowerEdge XR12 ストレージ コントローラーの仕様

内部コントローラ	外部コントローラ
<ul style="list-style-type: none"> • Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x M.2 SSD 	

①メモ: * H345 は 2021 年 12 月から H355 に置き換わる予定です。

ドライブ仕様

PowerEdge XR12 システムは、6 x 2.5 インチのホットスワップ対応 SAS、SATA、NVMe SSD をサポートします。

①メモ: NVMe ドライブは、ライザー 1A を搭載した前面アクセス構成ではサポートされていません。

ポートおよびコネクタの仕様

USB ポートの仕様

表 10. 背面アクセス構成の PowerEdge XR12 USB ポートの仕様

正面		背面		内蔵	
USB ポート タイプ	数 (ポート)	USB ポート タイプ	数 (ポート)	USB ポート タイプ	数 (ポート)
USB 2.0 対応ポート	1 回	USB 2.0 対応ポート	1 回	内蔵 USB 3.0 対応ポート。	1 回
iDRAC Direct 用の Micro-USB 2.0 対応ポート	1 回	USB 3.0 対応ポート	1 回		

表 11. 前面アクセス構成の PowerEdge XR12 USB ポートの仕様

正面		内蔵	
USB ポート タイプ	数 (ポート)	USB ポート タイプ	数 (ポート)
USB 2.0 対応ポート	2 台または	内蔵 USB 3.0 対応ポート	1 回
USB 3.0 対応ポート	1 回		
iDRAC Direct 用の Micro-USB 2.0 対応ポート	1 回		

①メモ: 内蔵 USB ポートはライザー 1B で使用でき、USB メモリー キーがサポートされています。

①メモ: USB メモリー キーはライザー 1A ではサポートされていません。

GPU の仕様

PowerEdge XR12 システムは、ライザー構成に基づいて、2 個の 70 W または 150 W (シングル幅/フル ハイット/フル レングス) GPU または 2 個の 300 W (ダブル幅/フル ハイット/フル レングス) GPU をサポートします。

シリアル コネクタの仕様

PowerEdge XR12 システムは、背面アクセス構成の背面および前面アクセス構成の前面にある 9 ピン コネクタ データ 端末装置 (DTE) 16550 準拠 シリアル コネクタ 1 個をサポートします。

NIC ポートの仕様

PowerEdge XR12 システムでは、4x 25GbE SFP+を提供する 4 個の内蔵 LOM ポートがサポートされています。これらのポートでは、10GbE および 25GbE がサポートされます。

また、1GbE がサポートされる専用の iDRAC 管理ポートも準備されています。

VGA ポートの仕様

PowerEdge XR12 システムは、背面アクセス構成の背面にある 1 個の DB-15 ビデオ グラフィック アレイ (VGA) ポート、および前面アクセス構成の前面にある 1 個の DB-15 VGA ポートをサポートします。

ビデオの仕様

PowerEdge XR12 システムは、16 MB のビデオ フレーム バッファを備えた内蔵 Matrox G200 グラフィックス コントローラーをサポートしています。

表 12. システムでサポートをしているビデオ解像度のオプション

解像度	リフレッシュレート (Hz)	色深度 (ビット)
1024 x 768	60	8、16、32
1280 x 800	60	8、16、32
1280 x 1024	60	8、16、32
1360 x 768	60	8、16、32
1440 x 900	60	8、16、32
1600 x 900	60	8、16、32
1600 x 1200	60	8、16、32
1680 x 1050	60	8、16、32
1920 x 1080	60	8、16、32
1920 x 1200	60	8、16、32

環境仕様

PowerEdge XR12 システムは、ASHRAE A2/A3/A4 および Rugged の環境カテゴリーで作動します。

メモ: 環境証明の詳細については、www.dell.com/support/home の [マニュアル] > [規制情報] にある『製品環境データシート』を参照してください。

表 13. ASHRAE A2 の継続作動仕様

	許容可能な継続動作
高度 <= 900 m (<= 2,953 ft) の温度範囲	10 ~ 35°C (50 ~ 95°F)、装置への直射日光なし
湿度範囲 (常に結露なし)	8% RH で最低露点 -12°C ~ 80% RH で最大露点 21°C (69.8°F)
動作高度減定格	900 m (2953 フィート) を越える高度では、最高温度は 300 m ごとに 1°C (984 フィートごとに 33.8°F) 低くなります。

表 14. ASHRAE A3 の継続作動仕様

	許容可能な継続動作
高度 <= 900 m (<= 2,953 ft) の温度範囲	5 ~ 40°C (41 ~ 104°F)、装置への直射日光なし
湿度範囲 (常に結露なし)	8% RH で最低露点 -12°C ~ 85% RH で最大露点 24°C (75.2°F)

表 14. ASHRAE A3 の継続作動仕様 (続き)

	許容可能な継続動作
動作高度減定格	900 m (2953 フィート) を越える高度では、最高温度は 175 m ごとに 1°C (574 フィートごとに 33.8°F) 低くなります。

表 15. ASHRAE A4 の継続作動仕様

	許容可能な継続動作
高度 ≤ 900 m (≤ 2,953 ft) の温度範囲	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)、装置への直射日光なし
湿度範囲 (常に結露なし)	8% RH で最低露点 -12°C ~ 90% RH で最大露点 24°C (75.2°F)
動作高度減定格	900 m (2953 フィート) を越える高度では、最高温度は 125 m ごとに 1°C (410 フィートごとに 33.8°F) 低くなります。

表 16. Rugged の継続作動仕様

	許容可能な継続動作
高度 ≤ 900 m (≤ 2,953 ft) の温度範囲	(-5) ~ 55°C (23 ~ 131°F)、機器への直射日光なし
湿度範囲 (常に結露なし)	8% RH で最低露点 -12°C ~ 90% RH で最大露点 24°C (75.2°F)
動作高度減定格	900 m (2953 フィート) を越える高度では、最高温度は 80 m ごとに 1°C (410 フィートごとに 33.8°F) 低くなります

表 17. ASHRAE A2、A3、A4、および Rugged の一般的な環境仕様


	許容可能な継続動作
最大温度勾配 (動作時と非動作時の両方に適用)	1 時間で 20°C* (1 時間で 36°F)、15 分間で 5°C (15 分間で 41°F)、テープの場合は 1 時間で 5°C* (1 時間で 41°F)  メモ: * : テープハードウェアの ASHRAE 温度ガイドラインにより、これらは温度変化の瞬間レートではありません。
非動作時の温度制限	-40 ~ 65°C (-104 ~ 149°F)
非動作時の湿度制限	5% ~ 95% RH で最大露点 27°C (80.6°F)
非動作時の最大高度	12,000 メートル (39,370 フィート)
動作時の最大高度	3,048 メートル (10,000 フィート)

表 18. システムの最大耐久震度仕様

最大耐久震度	仕様
動作時	MIL-STD-810H、Method 514.8、1.04 Grms、2-500Hz、ランダムな振動、Figure 514.8D-11
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> MIL-STD-810H、Method 514.8、Category 4、Figure 514.8C-2、5 ~ 500 Hz、60 分/axis MIL-STD-810H、Method 514.8、Category 24、Figure 514.8E-1、20-2000Hz、60 分/axis

表 19. システムの最大衝撃パルス仕様

最大衝撃パルス	仕様
動作時	<ul style="list-style-type: none"> MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure I、11ms、20G MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure I、11ms、40G (SSD)
作動時 (海軍)	認可された軍事輸送用ケースで MIL-DTL-901E、Grade A、Class 2、Type A
ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedures I、11 ms、40G (SSD 搭載) MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedures I、11 ms、40G

粒子状およびガス状汚染物質の仕様

次の表では、粒子汚染およびガス汚染による機器の損傷または故障を防ぐために役立つ制限事項を定義します。粒子汚染またはガス汚染のレベルが指定された制限を超え、機器の損傷または故障の原因となる場合、環境条件の変更が必要になります。環境状態の修復は、お客様の責任となります。

表 20. 粒子状汚染物質の仕様

粒子汚染	仕様
空気清浄	<p>データセンターの空気清浄レベルは、ISO 14644-1 の ISO クラス 8 の定義に準じて、95% 上限信頼限界です。</p> <p>① メモ: この条件はデータセンターの環境にのみ適用されます。空気清浄要件は、事務所や工場現場などのデータセンター外での使用のために設計された IT 装置には適用されません。</p> <p>① メモ: データセンターに吸入される空気は、MERV11 または MERV13 フィルタで濾過する必要があります。</p>
伝導性ダスト	<p>空気中に伝導性ダスト、亜鉛ウィスカ、またはその他伝導性粒子が存在しないようにする必要があります。</p> <p>① メモ: この条件は、データセンター環境と非データセンター環境に適用されます。</p>
腐食性ダスト	<ul style="list-style-type: none"> 空気中に腐食性ダストが存在しないようにする必要があります。 空気中の残留ダストは、潮解点が相対湿度 60% 未満である必要があります。 <p>① メモ: この条件は、データセンター環境と非データセンター環境に適用されます。</p>

表 21. ガス状汚染物質の仕様

ガス状汚染物	仕様
銅クーポン腐食度	クラス G1 (ANSI/ISA71.04-2013 の定義による) に準じ、ひと月あたり 300 Å 未満。
銀クーポン腐食度	ANSI/ISA71.04-2013 の定義に準じ、ひと月あたり 200 Å 未満

① **メモ:** 50% 以下の相対湿度で測定された最大腐食汚染レベル

Rugged 認定と仕様

PowerEdge XR12 は、カスタム構成をすることで、最大温度 55°C の過酷な環境空間に対応します。これらの構成は、通信会社 (または電気通信) および軍事産業向けであるため、最大温度要件 55°C に加えて、業界固有の規準を満たしています。電気通信構成では、GR-63 および GR-1089 Telcordia 仕様に記載されている NEBS 要件に沿ってテストされます。軍事構成では、MIL-STD-810H、MIL-DTL-901E、MIL-STD-461G に従ってテストされます。

表 22. Rugged 認定と仕様

認定	仕様
[作動時温度]	-5°C ~ 55°C MIL810H Method 501.7 Proc II による 55°C 継続作動 MIL 810H Method 502.7 Proc II による -5°C 継続作動
[作動時衝撃]	MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure I、11ms、40 G (SSD)
[作動時衝撃 (海軍)]	認可された軍事輸送用ケースで MIL-DTL-901E、Grade A、Class 2、Type A
[非作動時衝撃]	MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedures V、11 ms、40 G (SSD)

表 22. Rugged 認定と仕様 (続き)

認定	仕様
[作動時振動]	MIL-STD-810H、Method 514.8、1.04 Grms、2-500Hz、ランダムな振動、Figure 514.8D-11 (SSD 搭載)
[非作動時振動]	MIL-STD-810H、Method 514.8、Category 4、Figure 514.8C-2、5-500 Hz、60 分/axis (SSD 搭載) MIL-STD-810H、Method 514.8、Category 24、Figure 514.8E-1、20 ~ 2000 Hz、60 分/axis (SSD 搭載)
[作動高度]	MIL-STD-810H、Method 500.6、Proc.II (オペレーショナル、エアー キャリッジ) 15,000 ft (安定化後 1 時間)
[非作動時高度]	MIL-STD-810H、Method 500.6、Proc.I (ストレージ、空輸)、40 Kft (安定化後 1 時間)
[導電/放射イミュニティー]	MIL-STD-461G
[砂とほこり (フィルター ベゼルでテスト)]	MIL-STD-810H、Method 510.7、Procedure I、25°C で 6 時間、49°C でさらに 6 時間ほこりを吹き付け (気候カテゴリー A1) MIL-STD-810H、Method 510.7、Procedure II、49°C で砂を吹き付け (気候カテゴリー A1)、風速 29 m/s、砂濃度 2.2 g/m ³ 、6 時間
[NEBS レベル 3]	GR-63-CORE および GR-1089-CORE

温度に関する制限のマトリックス

表 23. プロセッサとファンの温度に関する制限のマトリックス

設定/プロセッサ TDP	フィルター付きベゼルの前面および背面アクセス構成	最大環境温度
105 W	VHP ファン Ext.HSK	55°C
120 W	VHP ファン Ext.HSK	55°C
135 W	VHP ファン Ext.HSK	55°C
140 W	VHP ファン Ext.HSK	55°C
150 W	VHP ファン Ext.HSK	55°C
165 W	VHP ファン Ext.HSK	35°C
185 W	VHP ファン Ext.HSK	35°C
205 W	VHP ファン Ext.HSK	35°C
225 W	VHP ファン Ext.HSK	35°C

表 24. ラベル参照

ラベル	説明
VHP ファン	超ハイ パフォーマンスのファン
Ext.	拡張
HSK	ヒートシンク

背面アクセス構成での ASHRAE A3 の温度制限

- 5°C 未満でコールド ブートを行わないでください
- 150 W を超えるプロセッサ TDP はサポートされていません。
- 128 GB 以上の容量の DIMM およびインテル Optane PMem 200 シリーズはサポートされていません。
- Dell 認定外の周辺機器類カードはサポートされていません。
- GPU は非対応です。
- PCIe SSD は非対応です。
- BOSS M.2 はサポートされていません。
- 高温仕様 85°C のアクティブ光ケーブルが必要です。
- バッテリー搭載 PERC アダプターはサポートされていません。
- NVMe ドライブはサポートされていません。

背面アクセス構成での ASHRAE A4 の温度制限

- 5°C 未満でコールド ブートを行わないでください
- 150 W を超えるプロセッサ TDP はサポートされていません。
- 128 GB 以上の容量の DIMM およびインテル Optane PMem 200 シリーズはサポートされていません。
- Dell 認定外の周辺機器類カードはサポートされていません。
- GPU は非対応です。
- PCIe SSD は非対応です。
- BOSS M.2 はサポートされていません。
- 高温仕様 85°C のアクティブ光ケーブルが必要です。
- バッテリー搭載 PERC アダプターはサポートされていません。
- NVMe ドライブはサポートされていません。

Rugged 背面アクセス構成での温度制限

- 5°C 未満でコールド ブートを行わないでください
- 150 W を超えるプロセッサ TDP はサポートされていません。
- 128 GB 以上の容量の DIMM およびインテル Optane PMem 200 シリーズはサポートされていません。
- 冗長モードでは、2 つの PSU が必要です。PSU の障害が発生した場合、システム パフォーマンスが低下する可能性があります。
- Dell 認定外の周辺機器類カードはサポートされていません。
- GPU は非対応です。
- PCIe SSD は非対応です。
- BOSS M.2 はサポートされていません。
- 高温仕様 85°C のアクティブ光ケーブルが必要です。
- バッテリー搭載 PERC アダプターはサポートされていません。
- NVMe ドライブはサポートされていません。

前面アクセス構成での ASHRAE A3 の温度制限

- 5°C 未満でコールド ブートを行わないでください
- 150 W を超えるプロセッサ TDP はサポートされていません。
- 128 GB 以上の容量の DIMM およびインテル Optane PMem 200 シリーズはサポートされていません。

- Dell 認定外の周辺機器類カードはサポートされていません。
- GPU は非対応です。
- PCIe SSD は非対応です。
- 480 GB より大きい BOSS M.2 はサポートされません。
- NVMe ドライブはサポートされていません。

前面アクセス構成での ASHRAE A4 の温度制限

- 5°C 未満でコールド ブートを行わないでください
- 150 W を超えるプロセッサ TDP はサポートされていません。
- 128 GB 以上の容量の DIMM およびインテル Optane PMem 200 シリーズはサポートされていません。
- Dell 認定外の周辺機器類カードはサポートされていません。
- GPU は非対応です。
- PCIe SSD は非対応です。
- 480 GB より大きい BOSS M.2 はサポートされません。
- NVMe ドライブはサポートされていません。

Rugged 前面アクセス構成での温度制限

- 5°C 未満でコールド ブートを行わないでください
- 150 W を超えるプロセッサ TDP はサポートされていません。
- 128 GB 以上の容量の DIMM およびインテル Optane PMem 200 シリーズはサポートされていません。
- Dell 認定外の周辺機器類カードはサポートされていません。
- GPU は非対応です。
- PCIe SSD は非対応です。
- 480 GB より大きい BOSS M.2 はサポートされません。
- NVMe ドライブはサポートされていません。
- 55C の環境で Kioxia SAS SSD はサポートされていません。
- バッテリー搭載 PERC アダプターはサポートされていません。

その他の温度制限

- 空のスロットには DIMM ダミーが必要です。
- 空のスロットには HDD ダミーが必要です。
- 空のスロット 3 には PCIe ダミーが必要です。